



И всё-таки это произошло! Конкурирующие компании AMD и Intel объединились для создания принципиально новых процессоров семейства Intel Core с графикой AMD Radeon.

Появление новинок на рынке планируется в первом квартале 2018 года.

Комбинированный чип AMD-Intel станет очередной ступенью в эволюции H-серии мобильных процессоров Intel Core. Сегодняшние чипы Core H-серии имеют типичное тепловыделение 45 Вт, базируются на дизайне Kaby Lake и комплектуются интегрированным видеоускорителем GT2. С появлением Core с графикой Radeon они, очевидно, получат гораздо более продвинутое графические возможности, что позволит использовать их в игровых портативных компьютерах без дополнительных дискретных графических ускорителей. При этом обещается, что перспективные комбинированные процессоры, составленные из компонентов AMD и Intel, будут работать в системе как привычные монолитные решения с интегрированной графикой: например, они смогут поддерживать все необходимые энергосберегающие функции. Появление новинок на рынке планируется в первом квартале 2018 года.

Хотя в разработке комбинированного Core с графикой Radeon принимали участие сразу две компании, этот процессор представляется как продукт компании Intel, которая

играла в разработке ведущую роль и обратилась к AMD лишь за графической частью. AMD в свою очередь говорит о том, что Radeon, сделанный для Intel, — специальный проект, подобный чипам, которые она разрабатывает для производителей игровых приставок. Впрочем, подробности реализации Core с графикой Radeon пока остаются нераскрытыми. Хотя Intel и говорит о перспективном продукте как о монолитном процессоре, в конечном итоге глубина интеграции составных частей непонятна: Core-Radeon может оказаться лишь продвинутой сборкой из нескольких чипов, совмещённых на одной подложке.

Тем не менее, определённое ноу-хау в Core-Radeon всё же есть. Как сообщается, основой представленного решения выступают специализированные кремниевые мосты EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge). Такие полупроводниковые кристаллы, представленные Intel в начале этого года, применяются для высокоскоростного соединения нескольких чипов, смонтированных на единой подложке. Основная идея состоит в том, что благодаря интеграции полупроводниковых мостов EMIB на поверхности подложки из текстолита, они обеспечивают высокую скорость и хорошую эффективность межчиповых соединений. В результате получается то, что Intel называет System-in-Package-модулем. В случае процессора Core с графикой Radeon технология EMIB позволила собрать воедино сразу три разнородных компонента: собственно процессор Core, графическое ядро Radeon и высокоскоростную графическую память HBM2.